

인텍플러스 (064290)

성장을 위한 준비는 끝났다!

성장을 위한 준비는 이미 마련

인텍플러스는 머신비전기술을 활용하여 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 2D/3D 외관 검사장비를 제조하는 기업이다. 매출성장을 위해서는 자금, CAPA, 신제품 개발/신규 고객사 확보 등 여러가지 제반 여건들이 마련되어야 한다. 동사를 이를 위한 준비를 마친 상황이다. 1)21.6월~22.10월 80억원의 CAPEX 투자를 통해서 CAPA가 기존대비 2배로 증가했다. 2) 검사장비는 수주시점과 매출인식시점이 상이하여 유동성을 위한 자금확보가 필요하다. 동사는 23.4분기 200억원 규모 전환사채 발행을 통해 준비가 되어 있다. 3)신제품 개발/신규 거래처 확보이다. 지속적인 고객사 확보 및 신규 검사장비 개발을 추진하고 있다.

글로벌 Top Tier 반도체 기업들의 행보에 주목

글로벌 반도체 기업들은 적층하는 패키징 방식을 지속적으로 확대할 예정이다. 이는 Inspection 입장에서 생각해보면 이전대비 넓은 면적의 검사, 다층 검사, 미세화 검사가 필요하다라는 의미이다. 동사는 경쟁사 대비 고속과 대면적 검사 관련 비교우위기술을 보유하고 있다. 즉, 적층 패키징 트렌드 확대 시 경쟁력이 부각될 수 있다. 북미 고객사는 2021년 3월 미래 전략으로 IDM 2.0 전략을 공개, 이후 다양한 지역에서 투자가 진행되고 있다. 국내와 대만 반도체 기업들도 신규 패키징 공정에 투자를 진행 중이거나 진행할 예정이다.

2024년 사상 최대 실적 기대

수주잔고 추이를 살펴보면 가장 많은 매출이 발생했던 2021~2022년을 상회하는 수주잔고가 이어지고 있다. 신규 고객사를 지속적으로 확보하고 있으며, 적층 패키징 확대로 동사의 경쟁력이 부각될 수 있는 상황이다. CAPA 증설 및 전환사채 발행을 통해 운영자금도 마련되어 있다. 2024년 사상 최대 실적이 기대되는 요인이다.



권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com

NOT RATED (I)

목표주가 원 (I)

현재주가 (1/25) 29,450원

상승여력 -

시가총액 3,780억원

총발행주식수 12,835,962주

60일 평균 거래대금 69억원

60일 평균 거래량 218,033주

52주 고/저 46,350원 / 15,050원

외인지분율 0.00%

배당수익률 1.45%

주요주주 이상윤 외 2인

주가수익률 (%) 1개월 3개월 12개월

절대 (1.5) (1.2) 80.2

상대 2.2 (7.5) 60.2

절대 (달러환산) (3.9) (0.1) 66.2

Forecasts and valuations (K-IFRS 개별)

(억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2021A	2022A	2023F	2024F
매출액	1,197	1,188	741	1,300
영업이익	275	194	-103	155
지배순이익	226	163	-142	108
PER	13.2	16.4	-27.3	34.9
PBR	5.7	3.8	7.3	6.0
EV/EBITDA	10.8	13.7	-41.5	24.5
ROE	55.6	27.7	-23.9	19.3

자료: 유안타증권

성장을 위한 준비는 끝났다!

회사개요

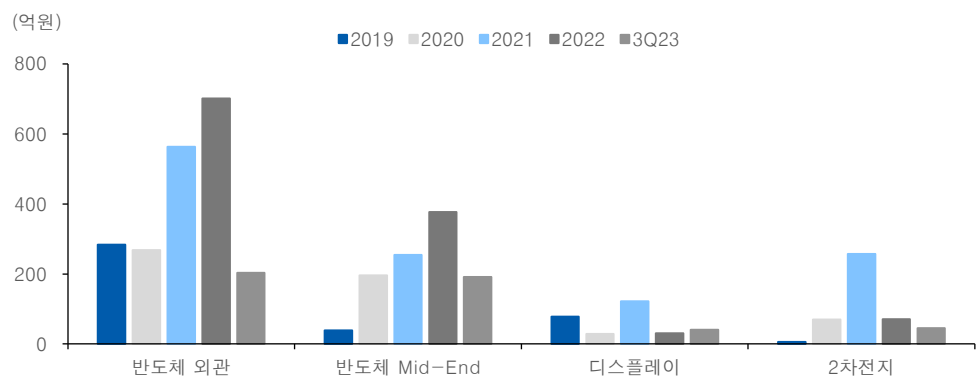
인텍플러스는 머신비전기술을 활용하여 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 2D/3D 외관검사장비를 제조하는 기업으로 3개의 사업부로 구성되어 있다. 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 다양한 산업에 진출, 판매하고 있으며, 스마트팩토리 분야로의 진출도 진행하고 있다.

1사업부는 반도체 후공정 외관검사 분야로 반도체 패키징, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 등의 장비로 구성되어 있다. 2019년 이후 글로벌 반도체 기업으로 반도체 패키징 검사장비를 단독 공급하면서 동사의 실적 성장을 견인하였다. 2022년 이전까지 전체 매출액의 절반 이상을 차지하는 주력 사업부이다.

2사업부는 반도체 Mid-End 외관검사장비 사업부이다. FC-BGA 검사장비가 대표적이다. 2016년 글로벌 반도체사향 장비 개발&납품을 통해서 성장하고 있다.

3사업부는 디스플레이와 2차전지 검사장비이다. 2017년부터 6세대 OLED 최종 공정의 외관을 검사하는 장비를 업계 최초로 개발 및 공급하고 있다. 국내 대형 2차전지 셀 제조업체들에 셀 외관검사장비와 셀 제조 과정에서의 비전솔루션도 제공하고 있다.

[그림1] 사업부별 매출추이



자료: 인텍플러스, 유안타증권 리서치센터

성장을 위한 준비는 이미 마련

매출 성장을 위해서는 자금, CAPA, 신제품 개발/신규 고객사 확보 등 여러가지 제반 여건들이 마련되어야 한다. 동사를 이를 위한 준비를 마친 상황이다.

첫째, CAPA 확대이다. 동사는 과거 두차례나 전년대비 2배 이상 성장한 경험을 보유하고 있다. 2018년 매출액 161억원에서 2019년 405억원으로 151.6% 증가했으며, 2020년 563억원에서 2021년 1,197억원으로 112.7% 성장했다. 2020~2021년의 경우 회사의 CAPA는 1,000억원이 었다. 당시 CAPA를 상회하는 수주를 받았다는 것을 의미하며, 이를 위해서 일부는 외주 가공을 한 경험이 있다. 외주 가공은 이익률이 떨어지는 요인이라는 점에서 긍정적이지 않다. 새로운 도약을 위해서 동사는 2021년 6월부터 80억원의 CAPEX 투자를 통해서 2022년 10월 CAPA를 2천억원 수준으로 확대시켰다.

둘째, 자금이다. 검사장비는 수주시점과 매출인식 시점이 상이하며, 제조시점에서 비용이 선제적으로 투입된다는 점에서 매출성장이 기대되는 상황에서는 유동성을 위한 자금마련이 필요하다. 과거(2019년, 2021년)처럼 100% 이상의 매출성장이 기대되는 시점에서 특히 이러한 필요성이 제기될 수 있다. 이를 위해 동사는 2023년 11월 30일에 200억원 규모 전환사채를 발행했다. 전환사채 발행 시 흥미로운 몇 가지 요소가 있다. 1)표면이자율과 만기이자율이 0.0%이다. 2)전환가액이 40,798원으로 할증 발행되었다. 3)리픽싱은 90%로 36,719원이다. 23.11.30일 종가와 비교해도 높은 가격이다. 투자자들의 높은 기대치가 반영되어 있다는 것을 알 수 있다.

셋째, 신제품 개발/신규 거래처 확보이다. 북미 고객사향 차세대 기판 검사 장비 개발이 진행 중이다. 국내 고객사향 2D/3D 패키징 검사 장비를 수주 경험을 보유하고 있다. 향후 추가적으로 기대되는 신규 거래처는 대만 반도체 기업이다. 대만 기업으로 FC-BGA 장비를 납품한 레퍼런스가 있으며, 반도체 패키징 검사장비 진출을 위해 준비 중이다. 과거 북미 고객사향 납품 이후 글로벌 OSAT로 확대된 경험을 보유하고 있다. 신제품 개발 및 신규 거래처 확보가 진행될 경우 높은 성장을 보일 수 있다고 기대하는 이유이다. 국내외 신규 OSAT 기업 거래처 확보도 이어지고 있다.

[그림2] 24년 성장을 위한 마련된 준비



자료: 인텍플러스, 유안타증권 리서치센터

글로벌 Top Tier 반도체 기업들의 행보에 주목

1. 북미

동사는 2020년 북미 고객사향 반도체 패키징 검사장비를 공급하면서 실적이 레벨업 되었다. 북미 고객사의 투자 및 변화여부가 동사의 실적 전망에 중요한 영향을 미친다고 볼 수 있다. 북미 고객사는 2021년 3월 미래 전략으로 IDM 2.0 전략을 공개했다. 전략 공개 이후 다양한 지역에서 투자가 진행되고 있다.

미국 내에서는 뉴멕시코, 오하이오, 애리조나, 오리건주에서 투자를 진행 중이다. 2021년 5월 뉴멕시코 공장에 35억달러, 2022년 1월에는 오하이오주에 200억달러 투자를 발표를 했다. 22년 6월에 투자를 연기했지만, 2023년 10월 최종 계획을 발표했다. 2022년 8월에는 애리조나주에 300억달러 투자를 발표했으며, 2025년 완공하여 공장이 가동될 것으로 예상된다. 2023년 10월에는 오리건주에 200억달러 규모 반도체 공장을 신설하겠다는 계획을 발표했다.

유럽에서도 반도체 Fab 투자를 공식화했다. 2022년 3월 이탈리아와 아일랜드에 각각 45억유로, 120억유로 투자할 계획을 밝혔다. 2023년 6월에는 독일과 폴란드에 각각 300억유로, 46억달러 투자 의사를 표명했다. 이외에도 2023년 12월 이스라엘 지역에 250억달러 투자계획을 언급했다.

동사와 직접적으로 관련이 높은 후공정 패키징과 관련된 투자는 뉴멕시코주와 말레이시아 페낭, 폴란드 등이 있다. 말레이시아 내 추가 Fab 건설에 60억달러를 투자할 계획이다.

북미 고객사는 2000년대 이후부터 동일한 패키지에서 서로 다른 반도체를 결합하는 패키징(결합) 기술을 지속적으로 개발하고 있으며, 파운드리 재진출을 위해 패키징 기술을 강화한다는 전략을 밝혔다. FOVEROS, EMIB 등이 대표적인 기술이다. FOVEROS는 2019년에 개발된 3D 적층 기술로 실리콘 칩 다이(Die) 위에 또 다른 다이를 적층하는 기술이다. EMIB (Embedded Multi die Interconnect Bridge)는 복수의 칩 다이를 기판 위에 올려서 연결하는 구조이다.

기판의 변화 역시 Inspection 입장에서는 새로운 검사장비의 도입 기대감을 높인다. 북미 고객사는 유리기판 시장 선점을 위한 노력도 진행하고 있다. 2030년 내 업계 최초로 유리기판을 적용한 칩을 양산하겠다고 밝혔으며, 美 애리조나에서 10억달러 규모의 R&D 라인을 구축, 개발 중이다. 유리기판의 경우 기존 기판과 빛 반사 및 흡수 방법이 다르다는 점에서 검사장비 기업들과 공동 개발을 진행할 가능성이 높다.

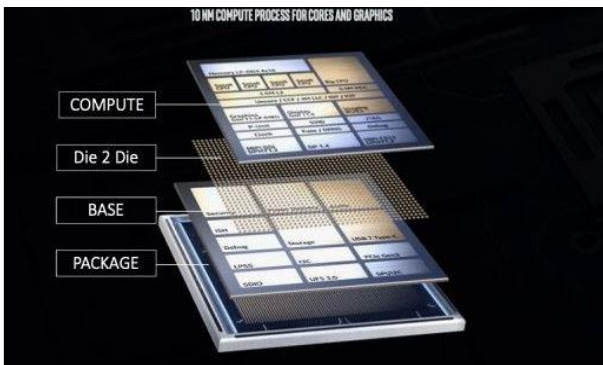
마지막으로 글로벌 Top Tier 반도체 기업을 고객사로 확보하면 OSAT 기업들로의 진출 확대가 예상된다. 글로벌 Top Tier 고객사 확보를 지속적으로 추진하는 이유이다.

[그림3] 북미 반도체 고객사의 IDM 2.0 전략 발표 이후 이어지는 반도체 Fab 투자

시기	지역	금액
2021년 5월	美 뉴멕시코	35억달러
2022년 1월	美 오하이오	200억달러
2022년 3월	이탈리아	45억유로
2022년 3월	아일랜드	120억유로
2022년 8월	美 애리조나	300억달러
2023년 6월	독일	300억유로
2023년 6월	폴란드	46억달러
2023년 12월	이스라엘	250억달러

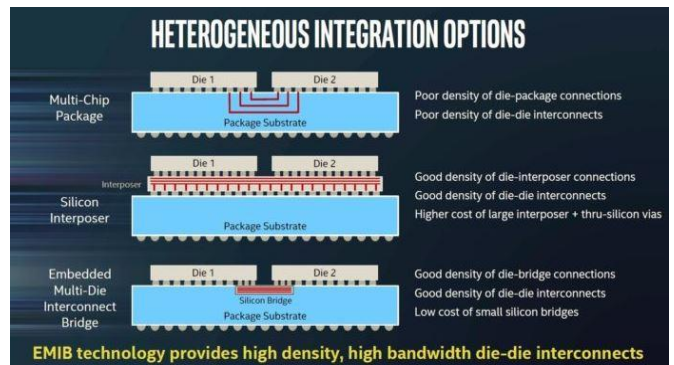
자료: 인텔, 언론보도 취합, 유안타증권 리서치센터

[그림4] FOVEROS



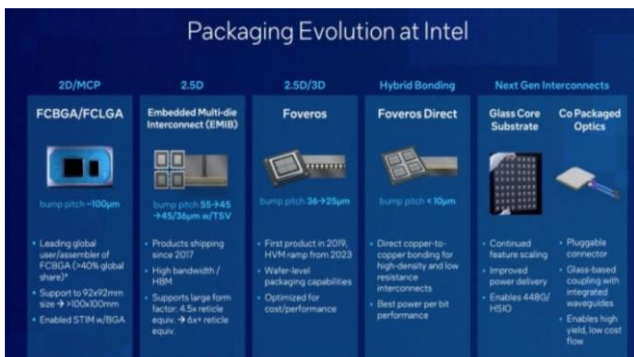
자료: 인텔, 유안타증권 리서치센터

[그림5] EMIB



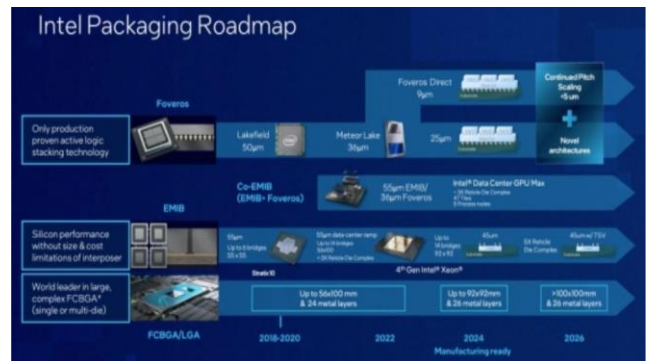
자료: 인텔, 유안타증권 리서치센터

[그림6] 어드밴스드 패키징의 진화



자료: 인텔, 유안타증권 리서치센터

[그림7] 패키징 로드맵



자료: 인텔, 유안타증권 리서치센터

2. 한국

국내 반도체 고객사는 로직 칩과 4개의 HBM 칩을 하나의 패키지로 구현하는 독자 구조의 2.5D 패키지 기술인 I-Cube를 2021년 5월에 공개했다. 실리콘 인터포저 위에 CPU, GPU 등의 로직과 HBM을 배치하여 하나의 반도체처럼 동작하도록 하는 이중 집적화 패키징 기술이다.

국내 반도체 고객사는 HBM 반도체 공급 확대하기 위해 2.5D 패키징 I-Cube 기술의 중요성을 강조하고 있다. 이에 올해 첨단 패키징 관련 2조원 규모의 투자를 진행할 것으로 기대된다. 동사는 2023년 하반기에 관련 검사장비를 납품한 경험을 보유하고 있다. 2024년 투자 확대 시 수혜가 예상된다.

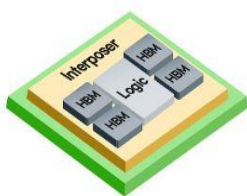
3. 대만

대만 반도체 기업은 어드밴스트 패키징 기술인 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)을 2012년 개발, 적용 확대하고 있다. CoWoS는 실리콘 소재 미세기판을 이용하여 수평뿐만 아니라 수직으로도 칩과 기판을 연결하는 패키징 기술이다.

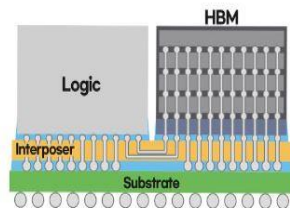
대만 반도체 기업은 7번째 첨단 패키징 공장 건설을 검토 중이며, 이는 CoWoS 제조공정을 이용한 패키징 및 테스트 공장이다. 동사는 대만 반도체 기업으로 장비를 납품한 경험이 있으며, 2D/3D 검사장비에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있다. 향후 진출 가능성이 있다고 판단된다.

요약하면, 미국/국내/대만 고객사들은 반도체 내 적층하는 패키징 방식을 지속적으로 확대시킬 예정이다. 이는 Inspection 입장에서 생각해 보면 과거보다 많은 면적의 검사, 다층 검사, 미세화 검사가 필요하다는 의미이다. 동사가 북미 고객사의 반도체 패키징 검사 장비 공급계약을 체결할 수 있었던 요인으로 고속과 대면적 검사 관련 비교우위기술이라는 점에서 적층될수록 동사의 경쟁력이 부각될 수 있다고 판단된다.

[그림8] I-Cube



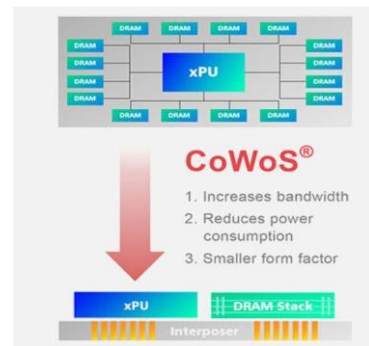
[I-Cube4 패키지 외관]
Logic과 4개의 HBM을 하나의 패키지로 구성



[I-Cube4 패키지 구성]
100 μ m 두께의 인터포저 안에 초미세 배선을 구현해 칩과 기판을 연결

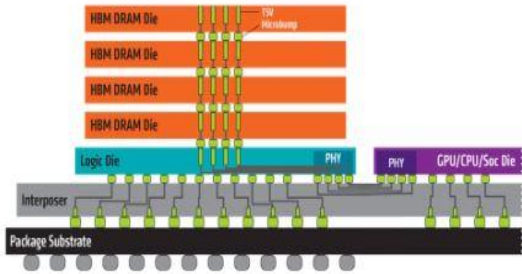
자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

[그림9] CoWoS



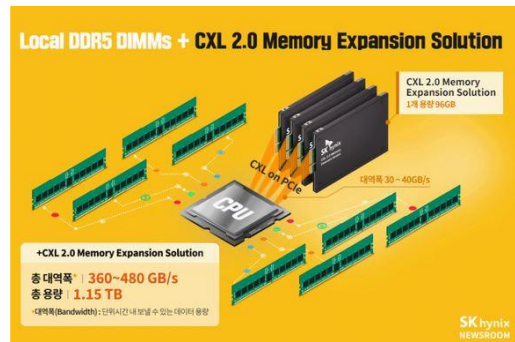
자료: TSMC, 유안타증권 리서치센터

[그림10] HBM



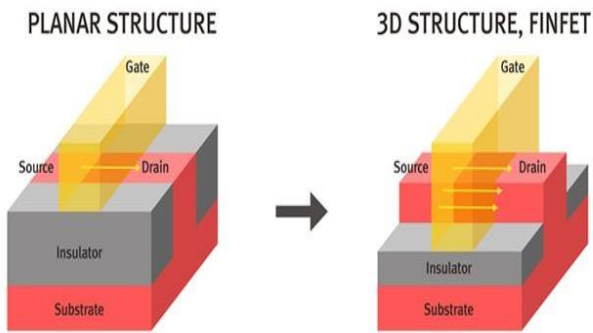
자료: AMD, 유안타증권 리서치센터

[그림11] CXL



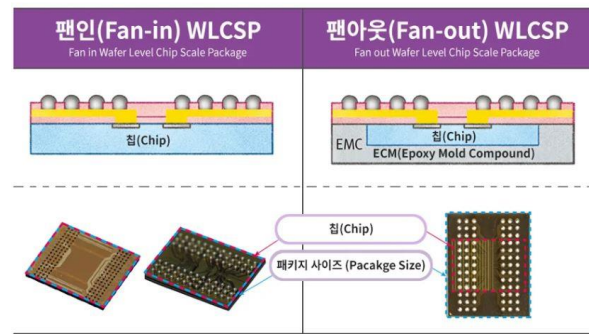
자료: SK 하이닉스, 유안타증권 리서치센터

[그림12] 핀펫



자료: 삼성전자, 유안타증권 리서치센터

[그림13] 팬아웃



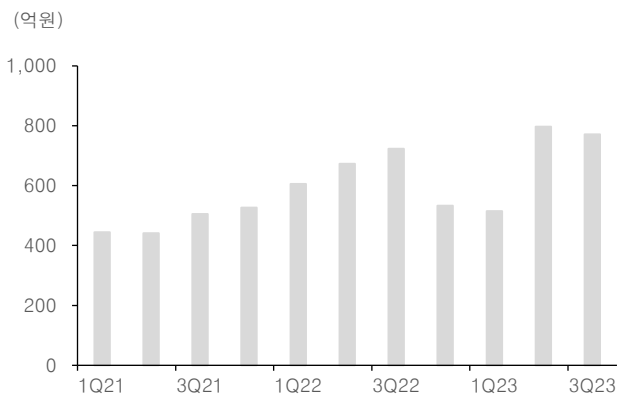
자료: SK 하이닉스, 유안타증권 리서치센터

2024년 사상 최대 실적 기대

2024년 예상실적은 매출액 1,300억원, 영업이익 155억원으로 전년대비 각각 75.4%, 흑자전환이 기대된다. 2024년 동사의 3개 사업부 모두 전년대비 실적 개선이 예상된다. 국내외 반도체 기업들과 OSAT 기업들의 투자 확대에 따른 매출성장이 기대된다. 1사업부의 실적 개선을 전망하는 이유이다. 국내외 FC-BGA 고객사들의 투자도 2024년 재개될 것으로 예상되어 2사업부 역시 전년대비 매출성장이 기대된다. 2차전지 검사장비는 기 수주된 계약이 2024년 연내 매출 인식으로 반영됨에 따라 3사업부 역시 성장할 것이다.

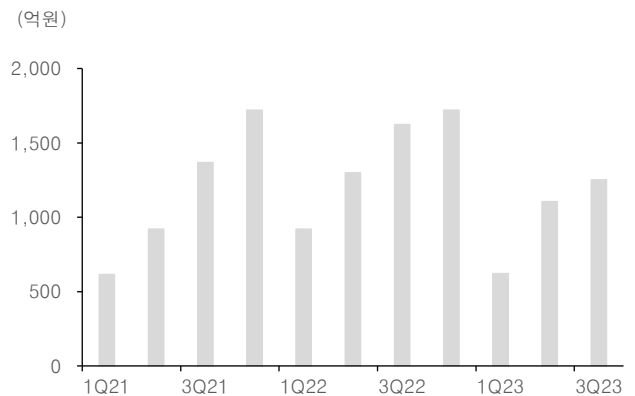
최근 수주잔고 추이를 살펴보면 가장 많은 매출액을 보였던 2021~2022년을 상회하는 수준이다. 신규 고객사를 지속적으로 확대하고 있으며, 반도체 패키징 관련 동사의 경쟁력이 부각될 수 있는 상황이다. CAPA 증설 및 전환사채 발행을 통해 운영자금도 마련되어 있다. 2024년 사상 최대 실적이 기대된다.

[그림14] 분기별 수주잔고 추이



자료: 인텍플러스, 유안타증권 리서치센터

[그림15] 분기별 수주총액 추이



자료: 인텍플러스, 유안타증권 리서치센터

인텍플러스 (064290) 추정재무제표 (K-IFRS 개별)

결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023F	2024F
매출액	563	1,197	1,188	741	1,300
매출원가	307	651	672	504	715
매출총이익	256	546	516	237	585
판매비	186	270	323	340	430
영업이익	70	275	194	-103	155
EBITDA	79	284	202	-95	162
영업외손익	-4	2	-4	-34	-35
외환관련손익	-11	17	30	0	0
이자손익	-1	-2	-3	-3	-4
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
기타	8	-12	-32	-32	-32
법인세비용차감전순손익	66	278	190	-137	120
법인세비용	-27	51	26	5	12
계속사업순손익	94	226	163	-142	108
중단사업순손익	-1	0	0	0	0
당기순이익	92	226	163	-142	108
지배지분순이익	92	226	163	-142	108
포괄순이익	83	224	172	-133	117
지배지분포괄이익	83	224	172	-133	117

주: 영업이익 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023F	2024F
영업활동 현금흐름	-11	-8	69	175	-149
당기순이익	92	226	163	-142	108
감가상각비	5	5	6	6	6
외환손익	5	-5	5	0	0
중속, 관계기업관련손익	1	0	1	0	0
자산부채의 증감	-129	-358	-162	237	-336
기타현금흐름	15	123	56	73	73
투자활동 현금흐름	5	-25	-118	-25	-48
투자자산	0	0	0	0	-1
유형자산 증가 (CAPEX)	-2	-19	-84	0	0
유형자산 감소	0	0	6	0	0
기타현금흐름	7	-6	-40	-26	-48
재무활동 현금흐름	14	109	7	-31	-29
단기차입금	10	117	9	-1	1
사채 및 장기차입금	1	11	-5	0	0
자본	6	6	8	0	0
현금배당	0	0	0	-25	-25
기타현금흐름	-4	-24	-5	-6	-6
연결범위변동 등 기타	0	0	0	-81	89
현금의 증감	8	76	-42	38	-137
기초 현금	59	67	142	100	138
기말 현금	67	142	100	138	1
NOPLAT	99	275	194	-106	155
FCF	-13	-27	-16	175	-149

자료: 유안타증권

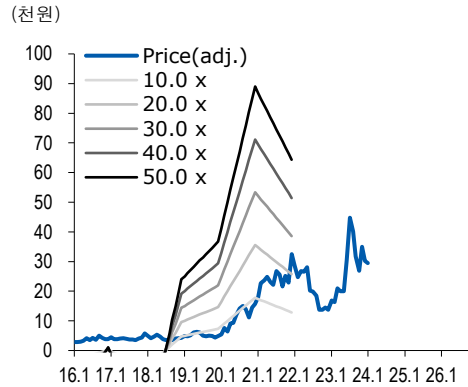
- 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
- 2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 증가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
- 3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023F	2024F
유동자산	358	896	873	625	847
현금및현금성자산	67	142	100	138	1
매출채권 및 기타채권	146	415	395	247	433
재고자산	111	324	337	210	369
비유동자산	168	178	289	281	275
유형자산	94	110	186	180	175
관계기업 등 지분관련자산	2	2	1	1	1
기타투자자산	7	25	25	25	25
자산총계	526	1,074	1,162	906	1,121
유동부채	191	520	487	388	511
매입채무 및 기타채무	85	182	83	52	91
단기차입금	80	195	205	205	205
유동성장기부채	10	5	20	20	20
비유동부채	28	46	4	3	4
장기차입금	5	20	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
부채총계	220	566	490	391	515
지배지분	307	508	672	514	606
자본금	63	63	64	64	64
자본잉여금	209	215	222	222	222
이익잉여금	49	261	410	244	327
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	307	508	672	514	606
순차입금	9	82	93	64	190
총차입금	97	224	229	228	229

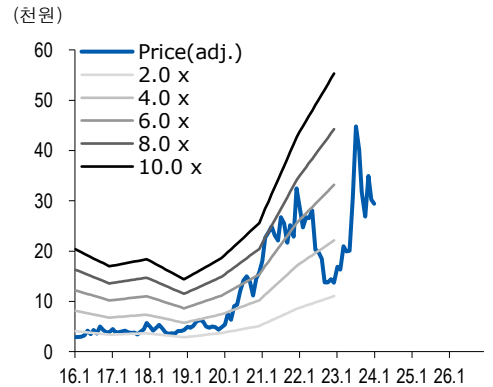
결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023F	2024F
EPS	733	1,787	1,284	-1,108	844
BPS	2,510	4,156	5,469	4,159	4,905
EBITDAPS	625	2,244	1,590	-745	1,262
SPS	4,473	9,446	9,343	5,795	10,128
DPS	100	200	200	200	200
PER	14.9	13.2	16.4	-27.3	34.9
PBR	4.4	5.7	3.8	7.3	6.0
EV/EBITDA	17.6	10.8	13.7	-41.5	24.5
PSR	2.4	2.5	2.3	5.2	2.9

결산(12월)	2020A	2021A	2022A	2023F	2024F
매출액 증가율 (%)	38.8	112.7	-0.7	-37.6	75.4
영업이익 증가율 (%)	49.2	292.3	-29.7	0.0	0.0
지배순이익 증가율 (%)	69.8	145.5	-27.9	0.0	0.0
매출총이익률 (%)	45.5	45.6	43.4	32.0	45.0
영업이익률 (%)	12.5	23.0	16.3	-13.9	11.9
지배순이익률 (%)	16.4	18.9	13.7	-19.1	8.3
EBITDA 마진 (%)	14.0	23.8	17.0	-12.8	12.5
ROIC	42.2	54.1	27.1	-18.3	23.5
ROA	19.5	28.3	14.6	-13.7	10.7
ROE	35.2	55.6	27.7	-23.9	19.3
부채비율 (%)	71.6	111.3	73.0	76.1	84.9
순차입금/자기자본 (%)	2.9	16.1	13.9	12.5	31.3
영업이익/금융비용 (배)	27.9	80.6	36.8	-19.4	29.2

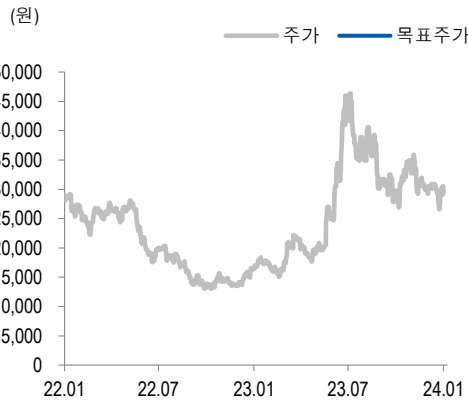
P/E band chart



P/B band chart



인텍플러스(064290) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2024-01-26	NOT RATED	-	1년		
2023-08-03	1년 경과 이후		1년		
2022-08-03	NOT RATED	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

- * 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	88.8
Hold(중립)	11.2
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2024-01-25

※해의 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 선정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자 : 권명준)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: 30%이상 Buy: 10%이상, Hold: -10~10%, Sell: -10%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.